

■ ガラスフリットの使用用途と適用できるガラス系の軟化温度

| 代表的用途 | 軟化温度(°C) | | | | | | 目的 |
|---------------------------------|--|-----|-----|-----|------|------|-----------|
| | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| セラミックパッケージ その他、ガラスシール | Bi ₂ O ₃ 系 | | | | | | 気密封止 |
| 金属配線カバーコート 磁性金属絶縁コート | Bi ₂ O ₃ 系 | | | | | | 絶縁性付与 |
| | P ₂ O ₅ 系 | | | | | | |
| | ZnO-B ₂ O ₃ 系 | | | | | | |
| | SiO ₂ -B ₂ O ₃ -R ₂ O系 | | | | | | |
| LTCC基板 (多層配線基板, 半導体パッケージ) | SiO ₂ -B ₂ O ₃ - R ₂ O系 | | | | | | 低温焼結 |
| グレーズド基板 (サーマルヘッド) | SiO ₂ -B ₂ O ₃ -R ₂ O系 | | | | | | 平滑性付与 |
| 太陽電池(銀電極) 基板内層電極 | Bi ₂ O ₃ 系 | | | | | | 密着性付与, 接合 |

※ 上記以外の用途でも、様々な組成系でのガラスの開発を承っています。
 詳細な情報、サンプルにつきましては、お問い合わせ下さい

お問い合わせ先

東罐マテリアル・テクノロジー株式会社
 〒531-8526 大阪市北区大淀北2-1-27

フリット事業部
 TEL:06-6456-0008

www.tomatec.co.jp
 FAX:06-6458-8911